産業標準案作成対象テーマの審議について

日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS 案作成規程に基づき、当該 JIS 案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA 事務局による“JIS 案の作成開始要件”を満たすことの前確認を経て、産業標準作成委員会にお諮りすることとなっております。

つきましては、次ページ以降の JIS 案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期待効果、JIS 案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますので、JIS 案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成委員会の下に JIS 素案の調査審議及び作成を行うための WG を設置することについても併せてご審議をお願いいたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 案作成対象テーマは、利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ウェブサイト掲載いたします。

※選定基準 3（産業標準化の利点・欠点）各コードの内容につきましては、
下記リンク先の 5～6 ページにてご確認いただけます。

「産業標準案等審議・審査ガイドライン」

URL <https://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/shingishinsa-guideline.pdf>

産業標準案作成対象テーマ一覧(制定)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号 (制定の場合は、仮の番号)	JIS案の名称	JIS案の英文名称	制定する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	10 金属・無機材料	制定	Z3199	鉛フリーはんだ対応はんだこて試験方法	The method for soldering iron corresponding to lead-free solder	<p>はんだ付けに使用されるはんだは、長らく「すず鉛」合金であったが、2006年に施行されたEU RoHS指令によって鉛が規制されたことから、現在は鉛フリーはんだが実用化されている。鉛フリーはんだは、鉛入りはんだに比べ融点が高く、はんだぬれ性が劣り、金属を侵食する力が強いなどの課題があり、国内外のはんだこてメーカーは、これらの技術的課題を克服するために、ヒータ、こて先、制御回路などはんだこての高性能化に取り組み、鉛フリーはんだの実用化に対応する装置の開発を進めてきた。</p> <p>一方、車載、家電、PCなどあらゆる電子基板のユーザにおいては、鉛フリーはんだ対応のはんだ付け装置を選定するに当たって、「WES2810 鉛フリーはんだ対応はんだこて試験方法」(日本溶接協会 2012年制定)を適用し、その性能、耐久性等を評価している。しかし、当該試験方法は制定から12年が経過し、この間、半導体、電子部品等の技術進歩に伴って、携帯電話、PC等の小型化による電子基板の微細化、大電流を制御するパワー半導体などの熱量の必要なのはんだ付け、自動化などはんだ付け関連技術も高度化しており、最新技術に対応できる方法に見直すことが必要となっている。また、同時に、鉛フリーはんだを用いた半導体、電子部品等が組み込まれる機器は、車載、携帯電話、PCのほか、宇宙、航空分野など、より高度な信頼性が求められる分野へと拡大しており、当該試験方法についても、国家規格として新たに制定することが求められている。</p>	<p>この規格の制定によって、最近の技術の実態を反映した試験方法による性能、耐久性等の評価が可能となり、鉛フリーはんだ対応はんだこての品質及び生産性の向上に寄与することが期待できる。ひいては、これらの装置によってはんだ付けされた半導体、電子部品等が組み込まれる機器の信頼性向上につながる。</p>	<p>—</p>		無	<p>第2条の該当号: 4(試験方法)</p> <p>対象事項: 鉱工業品(はんだこて)</p>	<p>法律の目的に適合している。</p>	<p>利点: イ、ウ</p> <p>欠点: いずれも該当しない。</p>		<p>関連する生産統計等によって市場におけるニーズが確認できる</p>	<p>一般社団法人日本溶接協会のWG</p>	<p>2025年9月</p>	